

2026 TSIA校園巡迴講座系列

國立中興大學專題講座

邁向智慧車輛時代的封測整合新篇章

Opening a New Chapter in IC Packaging and Testing Integration for the Smart Vehicle Era



合辦單位：台灣半導體產業協會 (TSIA)
國立中興大學 電機工程學系 (EE, NCHU)
日月光半導體製造股份有限公司 (ASE)

時間：2026年5月8日(五) 13:30~15:00

地點：國立中興大學 電機大樓一樓106室

地址：台中市南區興大路145號

主持人：電機工程學系 楊清淵 系主任兼教授

演講嘉賓：日月光半導體 林士絜 資深處長
台灣半導體產業協會 理事公司

